

昭 4  
(59) G C 4  
(59) G 0)

特 許 庁  
実 用 新 案 公 報

実用新案出願公告

昭43-29597

公告 昭43.12.4

(全2頁)

超小型回路装置

実 願 昭 41-35100  
出 願 日 昭 41. 4. 16  
考 案 者 平子征佳  
伊丹市大鹿字主ヶ池1三菱電機株  
式会社北伊丹製作所内  
出 願 人 三菱電機株式会社  
東京都千代田区丸の内2の12  
代 表 者 大久保謙  
代 理 人 弁理士 鈴木正尚

図面の簡単な説明

図はこの考案の一実施例を示すもので、第1図は超小形回路部品とプリント基板との間に放熱板をとりつけた状態図を示し、第2図は第1図のものに対し更に別の放熱板をとりつけた状態の断面図を示す。

考案の詳細な説明

この考案は半導体装置を使用した超小形回路装置の改良に係わり、特にその回路部品内部で発生する熱の放出に効果あるものを提供せんとするものである。以下この考案の一実施例について説明する。

即ち、第1図に示すように、回路部品1を基板2に対しとりつけるに当り、まずその両者間には

基板2に対しネジ4等で固定された熱の良導体から成る平板状の第一の放熱板3を介挿させ、その後第2図に示す如く、回路部品1に組み合わされる凹みを持った平板状の第二の放熱板5を回路部品1を覆う如く配置させている。図中6及び7は放熱板を基板2に対し固定されるためのナット・ワッシャを示している。

このようにこの考案に係わるものは、超小形回路部品1を第一の放熱板3を介してプリント基板2にとりつけ、更に第二の放熱板5を前記回路部品を覆うように配置させて成るものであるから、内部消費電力の大きな装置においても部品両面から有効な放熱が行われるので従来品に比し熱による破壊から部品を保護することができ、またケースの標準化並びに片面プリント基板への適用も可能となる等その実用的効果は極めて大きなものである。

実用新案登録請求の範囲

超小形回路部品を平板状に形成された第1及び第2の放熱板によつて挟持すると共に上記両放熱板をプリント基板に固定させるようにした超小形回路装置。

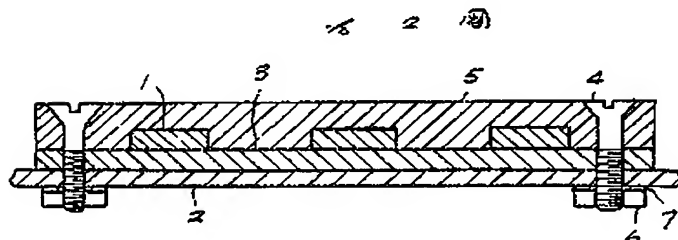
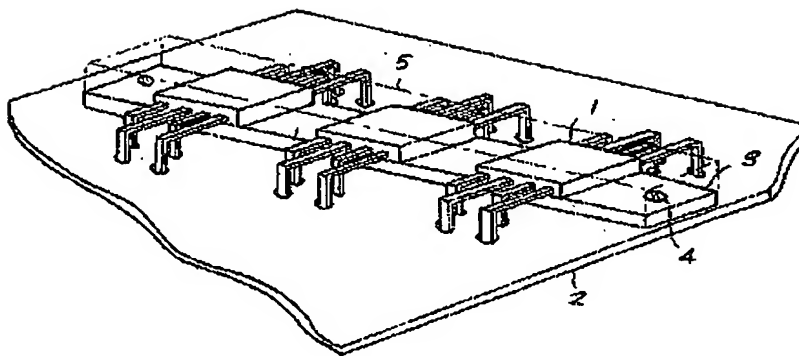
引用文献

特 公 昭38-11560

BEST AVAILABLE COPY

(2)

実公 昭48-29597



BEST AVAILABLE COPY